

## 1과목 : 전기전자공학(대략구분)

1. 멀티바이브레이터의 비안정, 단안정, 쌍안정이라고 말하는 것은 무엇으로 결정하는가?

- ① 전원의 크기      ② 바이어스 전압의 크기  
③ 저항의 크기      ④ 결합회로의 구성

2. 정현파의 파고율은 얼마인가?

- ①  $\sqrt{2}$       ②  $\frac{2}{\pi}$   
③  $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$       ④  $\frac{\pi}{2}$

3. 다음 사이리스터 중 단방향성 소자는?

- ① TRIAC      ② DIAC  
③ SSS      ④ SCR

4. 도체에 전압이 가해졌을 때 흐르는 전류의 크기는 가해진 전압에 비례한다는 법칙은?

- ① 줄의 법칙      ② 옴의 법칙  
③ 중첩의 법칙      ④ 키르히호프의 전류의 법칙

5. 저역통과 RC 회로에서 시정수가 의미하는 것은?

- ① 응답의 상승 속도를 표시한다.  
② 응답의 위치를 결정해 준다.  
③ 입력의 진폭 크기를 표시한다.  
④ 입력의 주기를 결정해 준다.

6. 다음 중 이상적인 연산증폭기의 특징으로 적합하지 않은 것은?

- ① 입력임피던스가 무한대이다.  
② 출력임피던스가 무한대이다.  
③ 주파수 대역폭이 무한대이다.  
④ 오픈 루프 이득이 무한대이다.

7. 다음 중 FET에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 입력임피던스가 매우 높다  
② 전압제어형 트랜지스터이다.  
③ BJT 보다 잡음특성이 양호하다.  
④ 베이스, 드레인, 게이트 전극이 있다.

8. 쌍안정 멀티바이브레이터의 결합저항에 병렬로 접속한 콘덴서의 목적은?

- ① 증폭도를 높이기 위한 것이다.  
② 스위칭 속도를 높이는 동작을 한다.  
③ 트랜지스터의 이미터 전위를 일정하게 한다.  
④ 트랜지스터의 베이스 전위를 일정하게 한다.

9. 고정 바이어스 회로를 사용한 트랜지스터의  $\beta$ 가 50이다. 안정도 S는 얼마인가?

- ① 49      ② 50  
③ 51      ④ 52

10. 수정진동자의 직렬공진주파수를  $f_0$ , 병렬공진주파수를  $f_s$  라

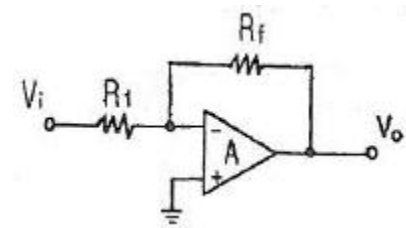
할 때 수정진동자가 안정한 발진을 하기 위한 리액턴스 성분의 주파수  $f$ 의 범위는?

- ①  $f_0 < f < f_s$       ②  $f_0 < f_s < f$   
③  $f_s < f < f_0$       ④  $f = f_s = f_0$

11. 다음 중 저주파 증폭기의 핵심능동소자로 알맞은 것은?

- ① 저항      ② 콘덴서  
③ 코일      ④ 트랜지스터

12. 다음 회로에서  $R_1 = R_f$  일 때 적합한 명칭은?



- ① 적분기      ② 감산기  
③ 부호변환기      ④ 전류증폭기

13. 일반적으로 크로스 오버 일그러짐은 증폭기를 어느 급으로 사용했을 때 생기는가?

- ① A급 증폭기      ② B급 증폭기  
③ C급 증폭기      ④ AB급 증폭기

14. 반송파 전력이 100 [W] 이고, 변조도 60 [%] 로 진폭변조시키면 피변조파의 전력은 몇 [W] 인가?

- ① 50 [W]      ② 100 [W]  
③ 118 [W]      ④ 136 [W]

15. 연산증폭기에서 차동 출력을 0 [V] 가 되도록 하기 위하여 입력단자 사이에 걸어주는 것은?

- ① 입력 오프셋 전압      ② 출력 오프셋 전압  
③ 입력 오프셋 전류      ④ 입력 오프셋 전류 드리프트

## 2과목 : 전자계산기일반(대략구분)

16. "D 플립플롭은 1개의 S-R 플립플롭과 1개의 ( ) 게이트로 수정할 수 있다."라는 문장에서 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

- ① AND      ② OR  
③ NOT      ④ NAND

17. 후입선출(LIFO) 동작을 수행하는 자료구조는?

- ① RAM      ② ROM  
③ STACK      ④ QUEUE

18. 중앙처리장치(CPU)를 구성하는 주요 요소로 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 연산장치와 보조기억장치  
② 입.출력장치와 보조기억장치  
③ 연산장치와 제어장치  
④ 제어장치와 입.출력장치

19. 명령어는 전자계산기의 동작을 수행시키기 위한 비트들의 집합으로 나뉘어진다. 각 명령어는 어떻게 구성되는가?

- ① 오퍼레이션코드와 실행프로그램
- ② 오퍼랜드와 목적프로그램
- ③ 오퍼레이션코드와 소스코드
- ④ 오퍼레이션코드와 오퍼랜드

20. 순서도를 작성하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 처리순서의 방향은 아래에서 위로, 오른쪽에서 왼쪽 화살표로 처리한다.
- ② 논리적 타당성을 확보할 수 있도록 작성한다.
- ③ 처리과정을 간단명료하게 표시한다.
- ④ 순서도가 길거나 복잡할 경우 기능별로 분할한 후 연결 기호를 사용하여 연결한다.

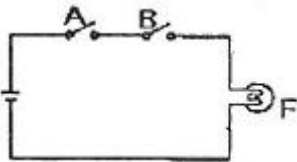
21. 컴퓨터 기억용량의 1k 바이트는 몇 바이트인가?

- ① 1000
- ② 1001
- ③ 1024
- ④ 1212

22. 데이터 처리 과정 및 프로그램 결과가 출력되는 전반적인 처리 과정의 흐름을 일정한 기호를 사용하여 나타낸 것을 무엇이라 하는가?

- ① 순서도
- ② 수식도
- ③ 로그
- ④ 분석도

23. 다음 스위치 회로를 볼 대수로 표현하면?



- ①  $F=A+B$
- ②  $F=A \cdot B'$
- ③  $F=A \cdot B$
- ④  $F=A' \cdot B$

24. 다음 중 일반적으로 가장 적은 bit로 표현 가능한 데이터는?

- ① 영상 데이터
- ② 문자 데이터
- ③ 숫자 데이터
- ④ 논리 데이터

25. 10진수 0.375를 2진수로 변환하면?

- ①  $(0.11)_2$
- ②  $(0.011)_2$
- ③  $(0.110)_2$
- ④  $(0.111)_2$

26. 논리식  $F=A'BC + AB'C' + ABC + ABC'$ 를 카르노맵에 의해 간소화 시킨 식은?

- ①  $F=AB + B'C$
- ②  $F=A + AC'$
- ③  $F=A'B + BC'$
- ④  $F=BC + AC'$

27. 상태 레지스터 중 2진 연산의 수행 결과 나타난 자리올림 또는 내림 상태를 판별하는 것은?

- ① Z(zero) 비트
- ② C(carry) 비트
- ③ S(sign) 비트
- ④ P(parity) 비트

28. 데이터 처리를 위하여 연산 능력과 제어 능력을 가지도록 하나의 칩 안에 연산 장치와 제어 장치를 집적시킨 것은?

- ① 컴퓨터
- ② 레지스터
- ③ 누산기
- ④ 마이크로프로세서

29. PCB를 가공할 때에는 부품 부착용 구멍(hole)을 만들며, 이 구멍은 부품과 배선과의 접속이 가능하도록 원형이나 사각형 등의 모양으로 부품이나 단자의 납땜 장소로 사용되는 것은?

- ① 랜드(land)
- ② 스루 홀(through hole)
- ③ 액세스 홀(access hole)
- ④ 트랙(track)

30. 인쇄회로기판이 갖추어야 할 특성과 거리가 먼 것은?

- ① 온도 상승에 대하여 변화가 적어야 한다.
- ② 납땜 시 가열 등에 의해서는 안정되어야 한다.
- ③ 기계적 강도를 갖추고, 가공이 용이해야 한다.
- ④ 공정 중 약물 처리에 대해 특성이 변화하여야 한다.

### 3과목 : 전자제도(CAD) 이론(대략구분)

31. 회전각도와 저항값 변화율에 따라 A형, B형, C형으로 구분되며, 포텐쇼미터(potentiometer)라고 하는 소자는?

- ① 탄소피막 저항
- ② 금속피막 저항
- ③ 가변저항
- ④ 권선저항

32. A4 용지의 크기를 올바르게 나타낸 것은?

- ① 841x1189(mm)
- ② 594x841(mm)
- ③ 420x594(mm)
- ④ 210x297(mm)

33. 회로를 CAD로 작성한 후 전기적인 연결 상태를 검증하는 것은?

- ① ERC(Electrical Rule Check)
- ② LRC(Line Rule Check)
- ③ CRC(Circuit Rule Check)
- ④ SRC(Schematic Rule Check)

34. 인쇄회로기판의 고밀도화를 촉진하는 요인이 아닌 것은?

- ① via 홀의 소형화
- ② 전자회로의 단순화
- ③ 부품의 SMT화
- ④ 인쇄회로기판의 다층화

35. PCB 제조 공정에서 소정의 배선 패턴만 남기고 다른 부분의 패턴을 제거하는 공정은?

- ① 천공
- ② 노광
- ③ 에칭
- ④ 도금

36. PCB 제조 공정에서 구리를 제거하기 위한 에칭액은?

- ① 염화나트륨
- ② 염화제이철
- ③ 크롬황산
- ④ 수산화나트륨

37. 다음 중 부품의 특성을 표시해야 하는 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부품 값
- ② 허용 오차
- ③ 정격 전압
- ④ 부품의 분류

38. 제도 용지에 직접 연필로 작성한 도면이나 컴퓨터로 작성한 최초의 도면을 무엇이라 하는가?

- ① 스케치도
- ② 복사도
- ③ 트레이스도
- ④ 원도

39. PCB 상에서 상호 연결되어 있는 신호, 모듈, 핀의 명칭으로

회로 도면상의 연결 정보를 무엇이라 하는가?

- ① Netlist                      ② Footprint  
③ Partlist                    ④ Libraies

40. 단면인쇄회로기판 설계 시 출력 데이터 파일의 내용이 아닌 것은?

- ① Drill Data                  ② Top Silk Screen  
③ Solder Side Pattern ④ Inner Layer Pattern

41. 유연성을 갖는 PCB로 절연기판이 얇은 필름으로 만들어진 것은?

- ① 페놀 단면 PCB            ② 에폭시 PCB  
③ 플렉시블 PCB            ④ 메탈 PCB

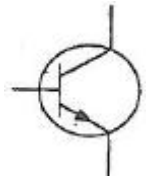
42. 패턴 설계 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 패턴은 가급적 굵고 짧게 해야 한다.  
② 패턴 사이의 간격을 최대한 붙여 놓는다.  
③ 배선은 가급적 짧게 하는 것이 다른 배선이나 부품의 영향을 적게 받는다.  
④ 전력용량, 주파수 대역 및 신호 형태별로기판을 나누거나 커넥터를 분리하여 설계한다.

43. 인쇄회로기판(PCB)을 제조 할 때 사용되는 제조 공정이 아닌 것은?

- ① 사진 부식법                ② 실크 스크린법  
③ 오프셋 인쇄법            ④ 대역 용융법

44. 다음 기호의 명칭으로 옳은 것은?



- ① NPN type transistor            ② PNP type transistor  
③ Phoyto type transistor          ④ Diode type transistor

45. 일반적으로 회로도를 설계할 때 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 대각선과 곡선은 가급적 피한다.  
② 주 회로와 보조 회로가 있는 경우에는 주 회로를 중심으로 그린다.  
③ 수동 소자를 중심으로 그리고, 능동 소자는 회로의 외곽에 그린다.  
④ 신호의 흐름은 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 그린다.

46. 전자회로설계에서 전체적인 동작이나 기능의 계통도로 그린 것은?

- ① 상세도                      ② 접속도  
③ 블록도                    ④ 기초도

47. 인쇄회로기판의 설계 요소 중 패턴 설계 시 유의할 점으로 옳지 않은 것은?

- ① 패턴 사이의 간격은 차폐를 행한다.  
② 일정 어스 방식으로 설계한다.  
③ 패턴은 가늘고 길게 한다.

④ 배선은 짧게 한다.

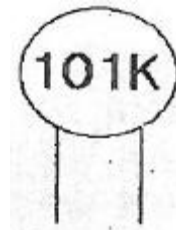
48. 전자 회로도나 블록도(Block diagram)와 같이 기호(Symbol)와 글자로만 도면이 이루어질 경우, 수치의 의미가 없거나 도면과 실물의 치수가 비례하지 않을 때 척도 난의 표기로 옳은 것은?

- ① 실측                        ② NC  
③ NS                        ④ 배척

49. 인쇄회로기판(PCB) 설계 시 고주파 부품 및 노이즈(noise)에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 아날로그, 디지털 혼재 회로에서 접지선은 분리한다.  
② 전원용 라인필터는 연결부위에 가깝게 배치한다.  
③ 고주파 부품은 일반회로 부분과 분리하여 배치하도록 하고, 가능하면 차폐를 실시하여 영향을 최소화 하도록 한다.  
④ 부품의 리드는 가급적 길게 하여 안테나 역할을 하도록 한다.

50. 다음 콘덴서의 정전용량 값과 허용오차는?



- ① 정전용량 : 0.001[μF], 허용오차 : ±0.1[%]  
② 정전용량 : 0.001[μF], 허용오차 : ±1[%]  
③ 정전용량 : 0.0001[μF], 허용오차 : ±10[%]  
④ 정전용량 : 0.0001[μF], 허용오차 : ±20[%]

51. 인쇄회로기판 가공에 사용되는 용어 중 부품의 단자 또는 도체 상호간을 접속하기 위하여 구멍 주위에 만든 특정한 도체 부분을 무엇이라 하는가?

- ① 랜드(Land)                ② 마운트(Mount)  
③ 패턴(Pattern)            ④ 홀(Hole)

52. 전자 CAD 패키지에 포함되어 있지 않은 프로그램은?

- ① 인쇄회로기판 설계용 프로그램  
② 회로 시뮬레이션용 프로그램  
③ 회로설계(Schematic)용 프로그램  
④ 부품 가공 데이터 작성용 프로그램

53. 다음 중 PCB 설계 후 곧바로 PCB를 제작할 수 있는 필름 출력이 가능한 장치는?

- ① X-Y 플로티                ② Photo 플로티  
③ Gerber Editor            ④ Ink jet 프린터

54. 사진이나 그림, 문서, 도표 등을 컴퓨터에 디지털화하여 입력하는 장치는?

- ① 터치스크린                ② 스캐너  
③ 키보드                      ④ 플로터

55. 다음 중 표면실장형 부품 패키지 형태가 아닌 것은?

- ① SMD                      ② DIP

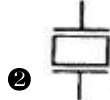
③ SOP

④ TQFP

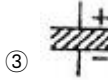
56. 수정 진동자를 나타내는 도 기호(symbols)는?



①



②



③



④

57. Through hole에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 층간의 상호 절연을 위한 것이다.  
 ② 홀의 한쪽이 층 내부에 묻혀 있다.  
 ③ 신호의 접지를 위한 홀이다.  
 ④ 부품면과 동박면을 도통하기 위한 것이다.

58. 다음 중 설계파일의 저장장치와 관련이 없는 것은?

- ① CD-RW                      ② 스캐너  
 ③ 하드디스크                ④ 플로피디스크

59. 다음 전자 소자 중 수동 소자는?

- ① 다이오드                    ② 트랜지스터  
 ③ 용량기                      ④ 집적회로

60. 다음 프린터 종류 중 비 충격(non-impact) 프린터는?

- ① 활자 프린터                ② 도트 프린터  
 ③ 펜 스트로크 프린터      ④ 레이저 빔 프린터

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	②	①	②	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	①	③	③	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	②	④	②	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	②	③	②	④	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	①	③	③	③	③	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	②	②	②	④	②	③	④